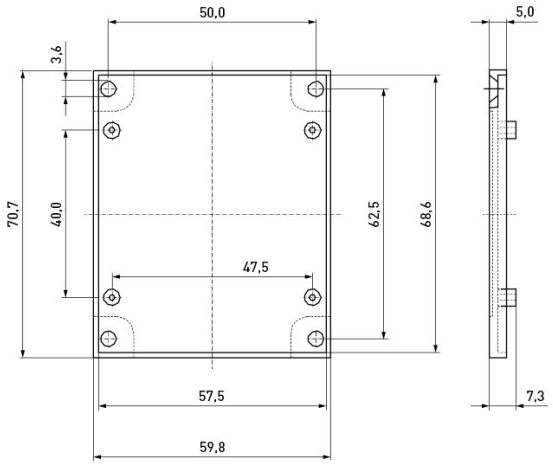
ETTINGER
Elektronik-Bauelemente

Artikeldatenblatt

Bodenplatte ohne Montagelaschen für Modulgehäuse

Artikel-Nr.: 086.04.720

Abbildung ggf. ähnlich



Bautyp:	Grundplatte
Breite [mm]:	59.8
Brennbarkeitsklasse:	UL94-HB
Farbe:	schwarz
Höhe [mm]:	5
Länge [mm]:	70.7
Material:	PA 6.0
Materialgruppe:	Kunststoff
Gewicht:	14.71g
Konformitäten:	Reach COMPLIANT, RoHS COMPLIANT, SVHC COMPLIANT

Alle Informationen erhalten Sie im Web auf unserer Artikeldetailseite

Sie wünschen eine individuelle Beratung ?
Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an products@ettinger.de.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ETTINGER GmbH

Ottostraße 5 | 85649 Hofolding | Deutschland | www.ettinger.de | info@ettinger.de | + 49 8104 66 23 88